全ての研究開発者に計算力を提供する
HPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）

高性能水冷AIワークステーション

HPC3000-NGB300TS-LC

NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip を搭載、大規模AI推論・生成AI向けに最適化された高性能水冷AIワークステーション

特 長

- NVIDIA® GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip を搭載
- 最大748GBのCoherent Memory を実現
- NVIDIA Blackwell B300 GPU による高性能AI処理
- 閉ループ水冷機構を採用載
- NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC による高速ネットワーク接続
- タワー / 5Uラックマウント対応筐体
- IPMI2.0 による遠隔監視・管理に対応
- OSなどソフトウェアのセットアップが不要

NVIDIA® GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip を搭載

HPC3000-NGB300TS-LC は、NVIDIA Grace 72コアCPU と Blackwell B300 GPU を統合した GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip を搭載しています。CPU と GPU を NVLink-C2C により高速接続することで、従来のPCI Express接続を超える低レイテンシかつ高帯域なデータ転送を実現し、大規模AIワークロードで優れた性能を発揮します。

最大748GBの Coherent Memory を実現

HPC3000-NGB300TS-LCは、496GB ECC LPDDR5X メモリと GPU 搭載の大容量 HBM3e メモリを統合し、最大748GBのCoherent Memory を実現します。CPU と GPU 間でメモリ空間を共有することにより、大規模言語モデルや長文コンテキスト処理において効率的なデータ処理が可能です。

NVIDIA Blackwell B300 GPU による高性能AI処理

HPC3000-NGB300TS-LC は、NVIDIA Blackwell B300 GPU を搭載し、FP4演算による高効率なAI推論性能を提供します。大規模生成AI、推論AI、マルチモーダルAIなどのワークロードにおいて、高いスループットと優れた電力効率を実現します。

閉ループ水冷機構を採用

HPC3000-NGB300TS-LC は、Direct-to-Chip方式の閉ループ水冷システムを採用しています。高発熱となる GB300 Superchip を効率的に冷却し、長時間の高負荷AI処理においても安定した動作を維持します。

NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC による 高速ネットワーク接続

HPC3000-NGB300TS-LCは、NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC を搭載し、400GbEポートを2基備えています。AIクラスタや高速ストレージ環境との接続に対応し、大規模分散推論や高速データ転送を実現します。

タワー / 5Uラックマウント 対応筐体

HPC3000-NGB300TS-LCは、タワー設置および5Uラックマウントの両方に対応した筐体を採用しています。研究室やオフィス環境への設置から、データセンターラックへの導入まで柔軟に対応可能です。

IPMI2.0 による 遠隔監視・管理に対応

標準搭載された IPMI2.0 機能により、専用LANポート経由でシステムの遠隔監視および管理を行うことができます。温度、電力、ファン動作などの監視に加え、遠隔からの電源制御やコンソール操作にも対応し、運用管理負荷を軽減します。

OSなどソフトウェアの セットアップが不要

お客さまの研究内容に応じて、OSやネットワークを含めた基本設定から、ジョブ投入できる状態に環境を整備するセットアップまでを行い、すぐに計算開始できる環境を提供いたします。ソフトウェアは当社が提供する「System Integration Pack (SIP)」を使用し、最適化された設定で出荷されます。これにより、研究用途に適した性能と安定性が確保され、計算リソースの効率的な活用が可能となります。

HPC3000-NGB300TS-LC

製品仕様

OS	Ubuntu 24.04 LTS
プロセッサー(CPU/GPU)	NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip
プロセッサー搭載数	NVIDIA Grace 72-Core Arm CPU 搭載
プロセッサー冷却方式	閉ループ水冷
メモリ	システムメモリ: 496GB LPDDR5X ECC GPUメモリ: 252GB HBM3e 統合Coherent Memory:最大748GB
メモリスロット	オンボード (メモリの追加・変更はできません)
GPU	NVIDIA Blackwell B300 GPU
GPUカード搭載数	1基
ディスクドライブ搭載数	M.2 NVMe Gen5 スロット ×4 最大:1.92TB NVMe SSD ×4 標準:960GB NVMe SSD ×3
光学ドライブ	内蔵不可
グラフィック	Aspeed AST2600(マネージメントプロセッサ内蔵)
インターフェイス	[前面] USB 2.0(Type-A、最大480Mbps) ×2 [背面] mini DisplayPort ×1 ※表示用GPU搭載時は出力機能をOFFに設定します。 USB 3.2 Gen 2(Type-A、最大10Gbps) ×4 10GBASE-T LANポート(RJ45) ×1 1GbE LANポート(IPMI専用、RJ45) ×1 400GbE NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC (QSFP) ×2
拡張スロット	PCI Express 5.0 x16 FHFL ×1 PCI Express 5.0 x8 FHHL ×2
電源ユニット	1600W ×1 (80PLUS Titanium 認証取得) 100V環境 1300W / 200V環境 1600W ※ 100V環境では電力制限が必要となる場合があります。200V環境での利用を推奨します。
ACケーブル	添付:100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P オプション:200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1 等
ACコネクタタイプ	IEC 320-C20
最大消費電力	1600W
筐体タイプ	タワー / 5Uラックマウント対応
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	455 mm × 218 mm × 701 mm
重量	40 kg (Net Weight)
附属品	100V 用AC ケーブル × 1 USBキーボード (英語) ×1 USB光学式スクロールマウス ×1 LANケーブル(CAT6A,3m) ×1 取扱説明書 保証書
動作環境条件	気温:10℃～25℃、湿度:8%～90%(結露なきこと)
保証	3年間センドバック保守

HPCシステムズ株式会社
本社
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
TEL:03-5446-5531　FAX:03-5446-5550　Mail:hpcs_sales@hpc.co.jp
西日本営業所
〒604-8153京都府京都市中京区笋町689番地
京都御幸ビル 8階 806(烏丸通四条上る)
TEL:075-353-0120　FAX:075-353-0121

販売店

■ この内容は、2026 年 10 月 01 日現在の内容です。
■ 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。
■ 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
■ Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。